

Investor Relations



PSK GROUP

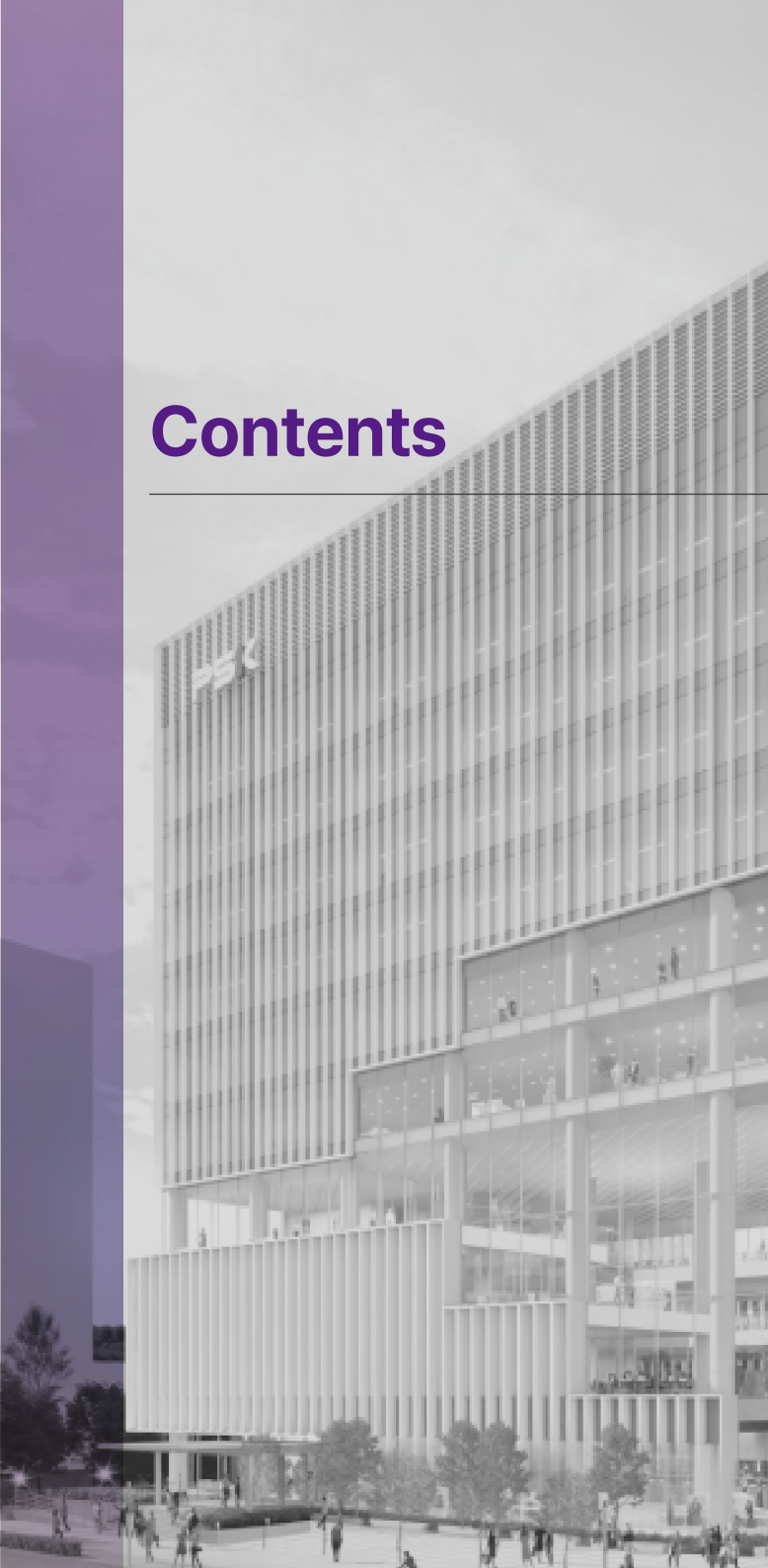
Aug. 2025

Disclaimer

여기에 포함된 2024년 말 PSK 그룹("회사")의 경영 성과 및 재무 결과에 관한 모든 정보는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.

여기에 포함된 정보는 투자자의 투자 결과와 관련하여 어떠한 법적 목적에도 활용되어서는 안 됩니다. 이에 따라 회사는 여기에 포함된 정보에 대한 투자자의 의존으로 인해 발생하는 손실 또는 손해에 대한 일체의 책임을 명시적으로 부인합니다.

이 자료의 일부 정보와 데이터는 가정과 미래지향적 진술에 기초하여 작성되었습니다. 이러한 미래지향적 가정과 진술은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하며 변경될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.



Contents

01 회사소개

PSK 그룹	05
연혁	06
네트워크	07
주요 고객사	09
경쟁력	10

02 사업소개

PSK	12
PSK 홀딩스	16

03 투자

연구활동	19
신제품	20
CapEx	22

04 ESG

ESG 경영	24
환경	25
사회	26
지배구조	28
고객사 평가	29

05 성과

재무정보	31
주가정보	33

회사소개



PSK 그룹	05
연혁	06
네트워크	07
주요 고객사	09
경쟁력	10



PSK 홀딩스

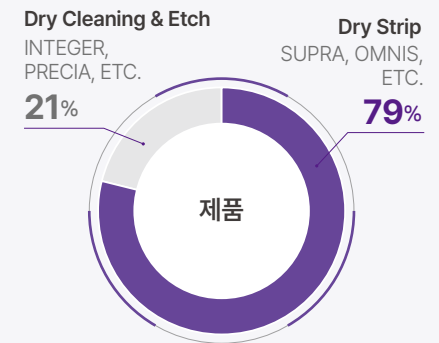
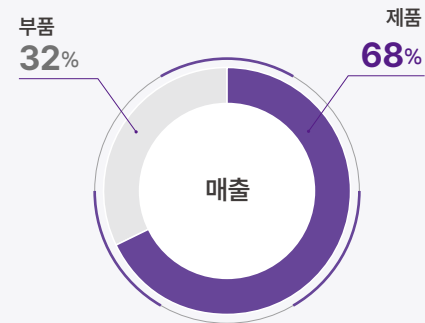
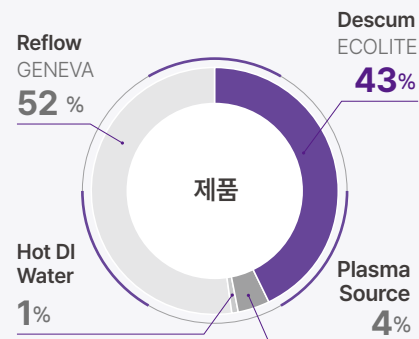
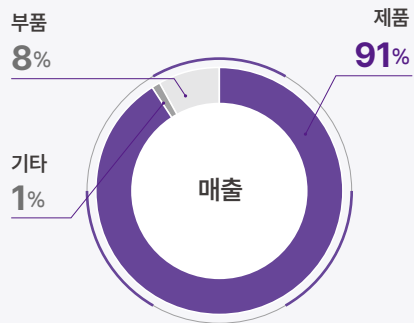
24년말 기준

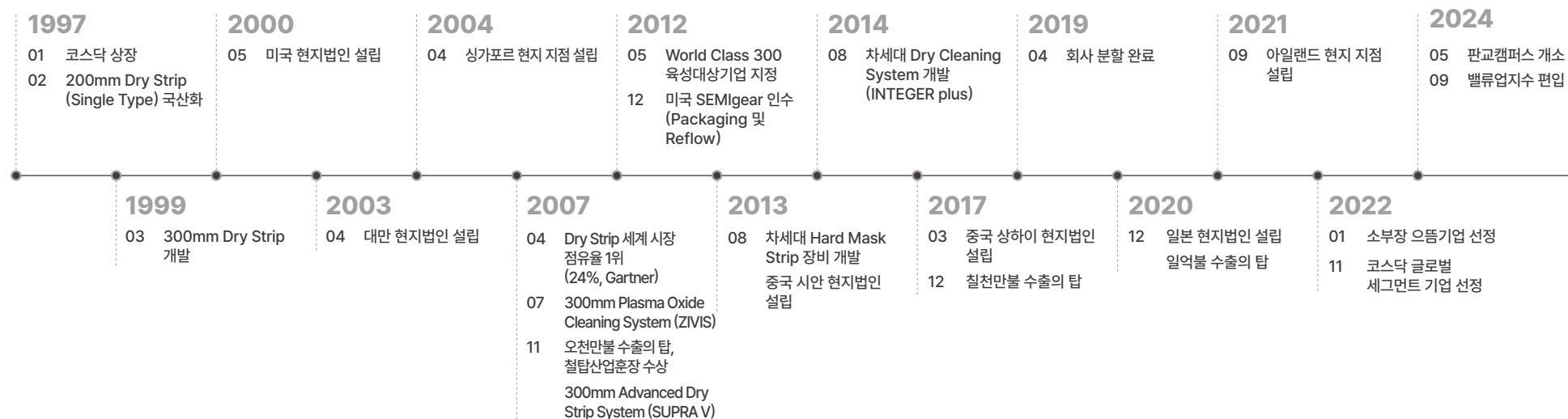
회사명	피에스케이홀딩스 주식회사
설립일	1990.06
자본금	107.8억
대표이사	박경수
주요사업	반도체 장비(292908)
임직원	112명
주소	경기도 화성시 삼경기도 화성시 삼성1로4길 48 우편번호 18449
CEO 약력	PSK 그룹 회장 1990 ~ 현재 PSK 홀딩스 대표이사 1990 ~ 현재 PSK 회장 2019 ~ 현재 코스닥 상장법인 협의회 회장 2007 ~ 2009

PSK

24년말 기준

회사명	피에스케이 주식회사
설립일	2019.04
자본금	146.2억
대표이사	이경일
주요사업	반도체 장비(292908)
임직원	330명
주소	경기도 화성시 삼성1로4길 48 우편번호 18449
CEO 약력	PSK 대표이사 2019 ~ 현재 PSK 2016 ~ 현재 Mattson Technology 2004 ~ 2015 Applied Materials 1996 ~ 2003

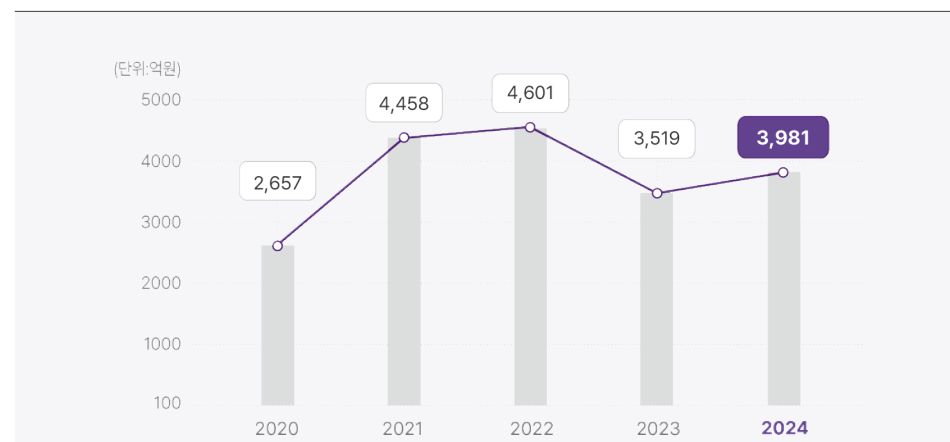




PSK Holdings 매출액 (연결)



PSK 매출액 (연결)



PSK
홀딩스소재지
대한민국 화성시

- 3D Package 장비 사업
- Fluxless Reflow 장비
- Descum 장비

32.76%

PSK

소재지
대한민국 화성시

- 웨이퍼 제조 장비사업
- Dry Strip 장비
- Dry Cleaning 장비
- Plasma Wafer Edge Cleaning 장비



SEMIgear

Fluxless Reflow 기술 원천



PSK Asia

현지 영업 및 현장 서비스업



PSK China

현지 영업 및 현장 서비스업



PSK Shanghai

부품 사업



PSK America

현지 영업 및 현장 서비스업



PSK Japan

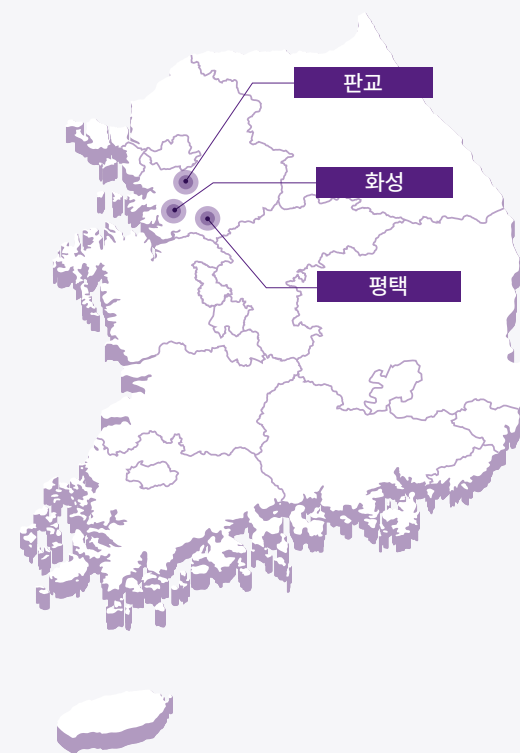
현지 영업 및 현장 서비스업



SE&S / SE&T / SE&I

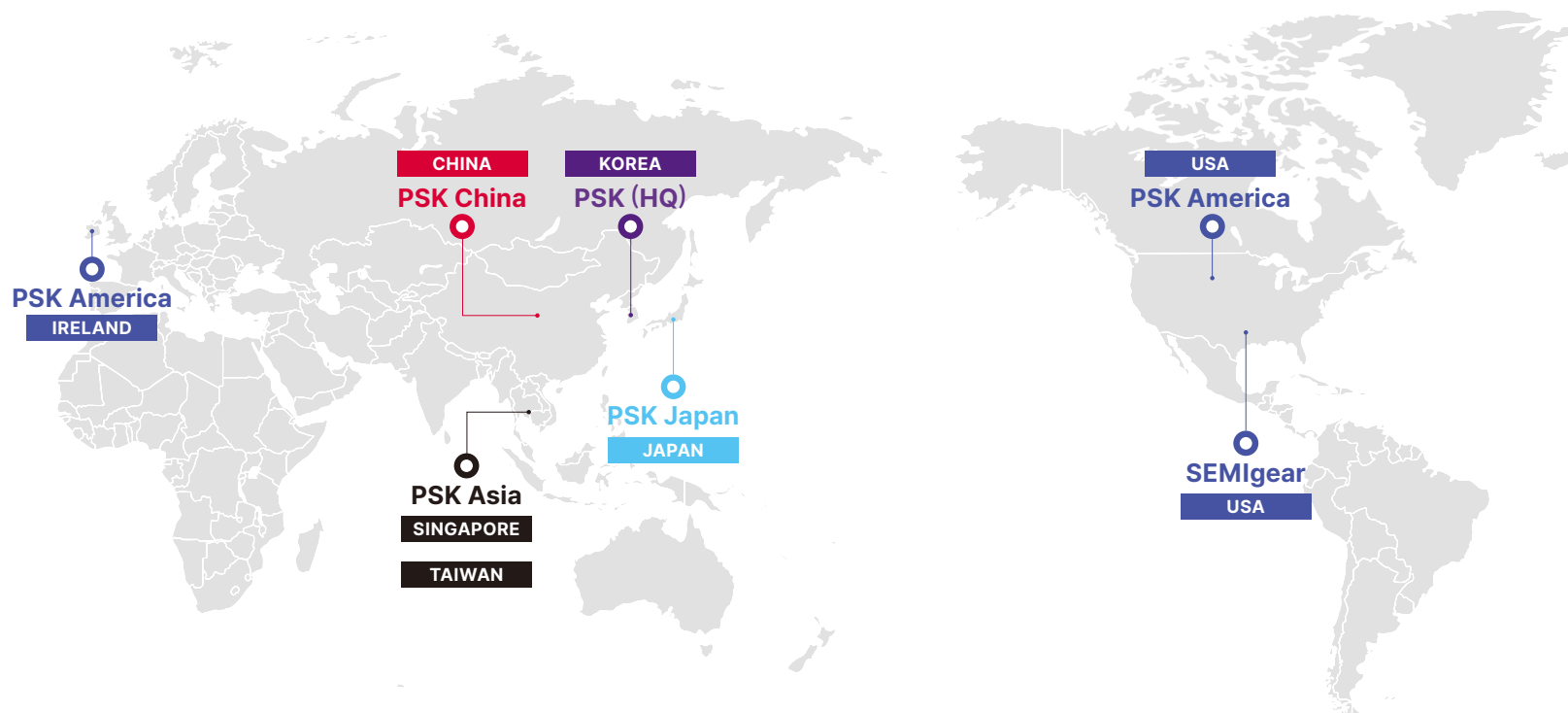
현장서비스업 / 부품조립업

대한민국





7 국가
25 거점



PSK (HQ)

- 화성
- 평택
- 판교

PSK Asia

- 신주
- 린커우
- 타이중
- 타이난
- 싱가포르

PSK China

- 시안
- 허페이
- 청두
- 우한
- 샤먼
- 취안저우
- 우시
- 다렌
- 상하이
- 베이징

PSK Japan

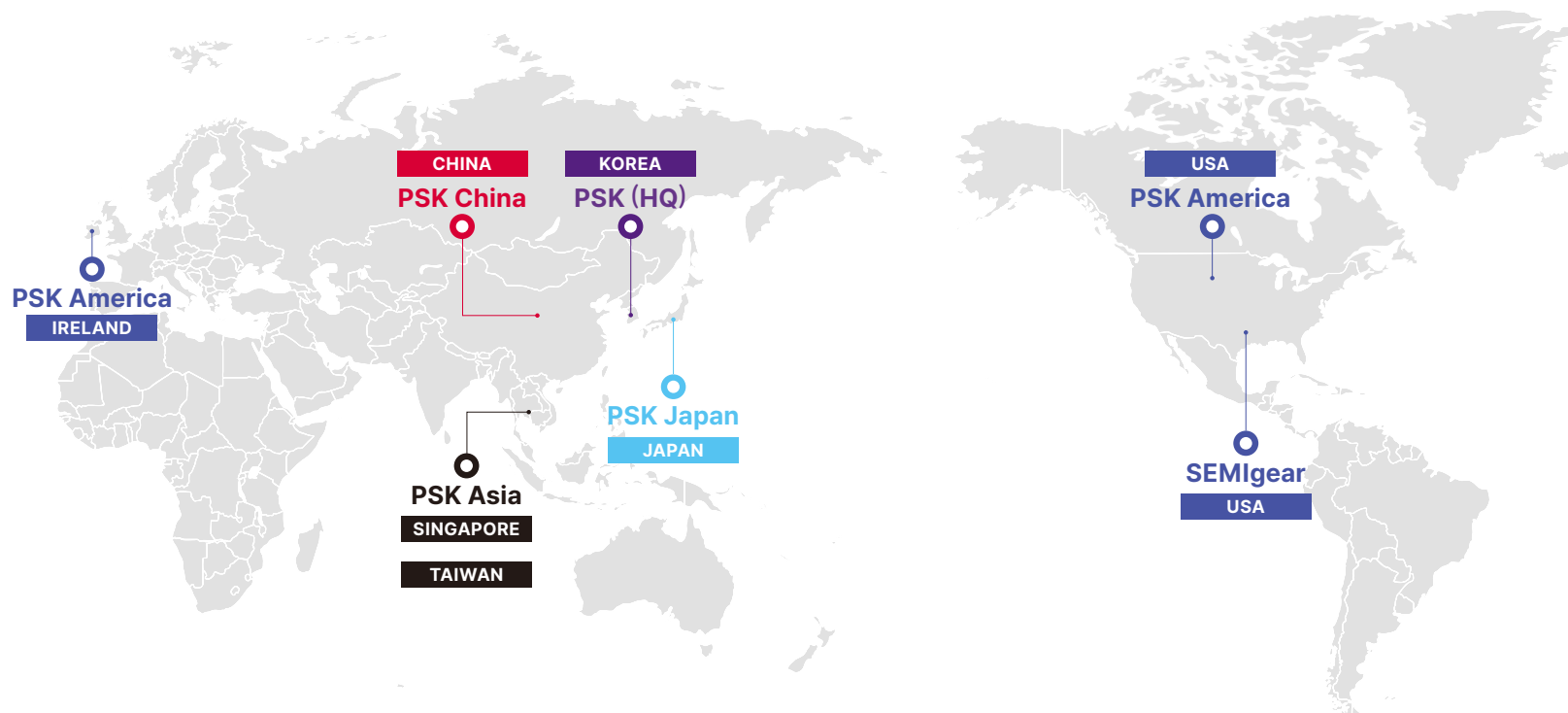
- 히로시마

PSK America

- 힐스버러
- 보이시
- 캔들러
- 오스틴
- 더블린

SEMIgear

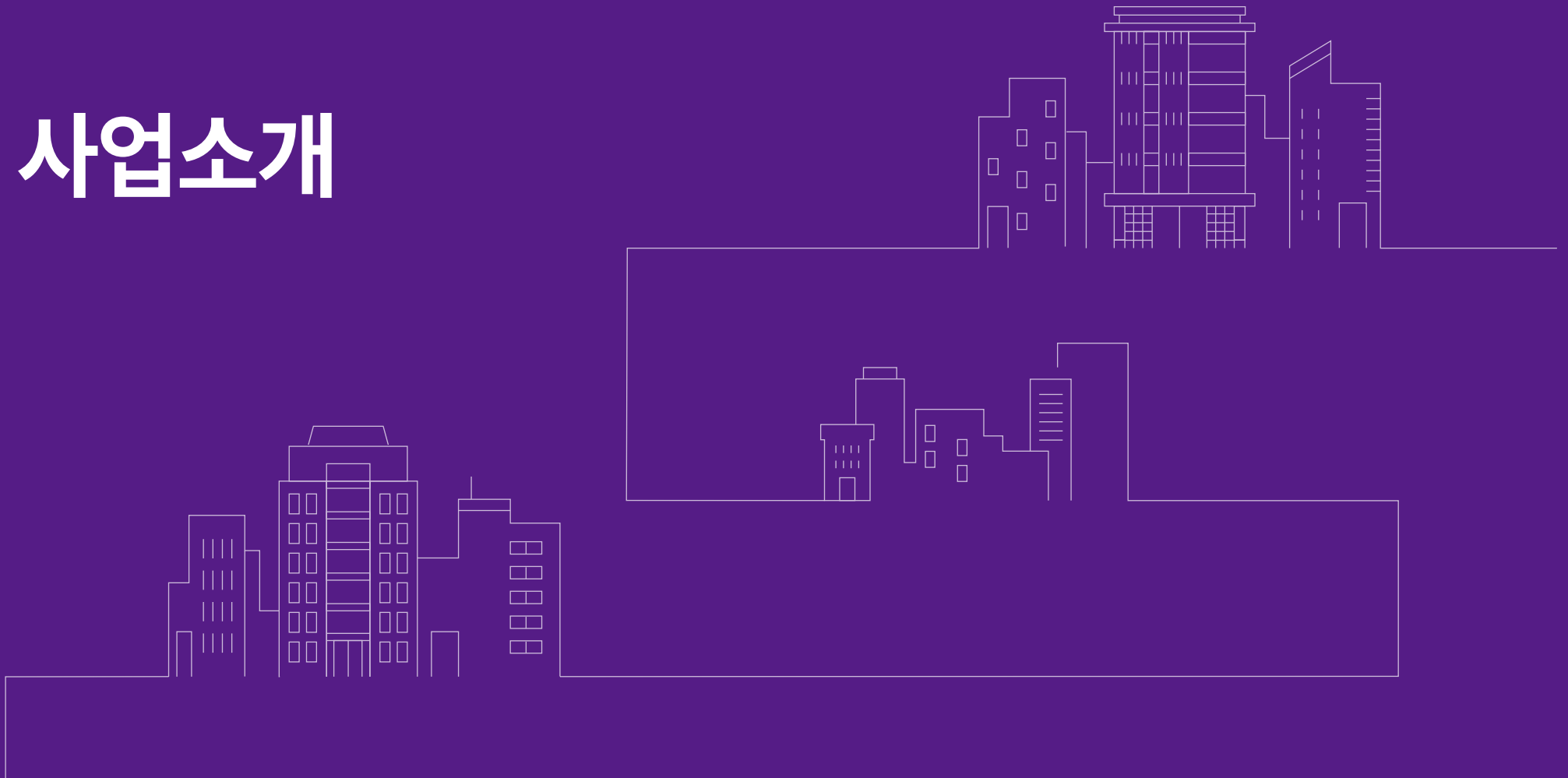
- 오스틴



Korea	China	Asia	USA
Europe	Japan		



사업소개



PSK	
Dry Strip	12
Dry Cleaning	13
New Hard Mask Strip	14
Bevel Etch	15

PSK 홀딩스	
Descum	16
Reflow	17



8대 공정

웨이퍼

산화

포토
리소그래피식각
[Asher]

박막 증착

금속 배선

EDS

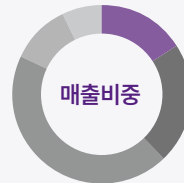
패키징

세계 최고 점유율 기반의 드라이 스트립 장비

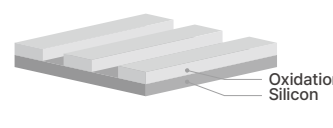
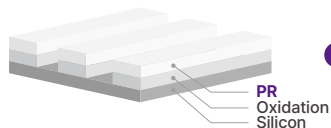
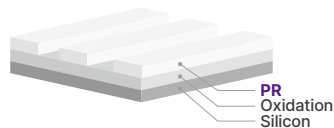
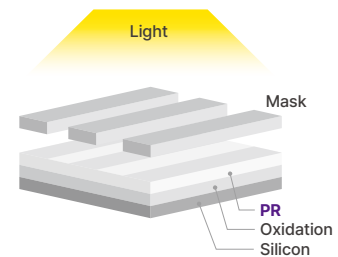
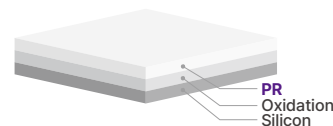
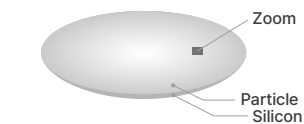
SUPRA는 안정적인 드라이 스트립 공정을 지원하며, 최소 면적 설계로 높은 처리량과 낮은 CoO를 구현합니다. ICP, CCP, MW 등 다양한 플라즈마 기술과 화학을 지원합니다. 또한 Bulk Strip뿐만 아니라 HDIS, Metal, Low-K 등 첨단 공정에도 적용할 수 있습니다.

특징

- High productivity
- High strip rate
- High reliability and low CoO



한국	16%
미국	22%
중국	44%
대만	11%
기타	7%





8대 공정

웨이퍼

산화

포토
리소그래피식각
[Etcher]

박막 증착

금속 배선

EDS

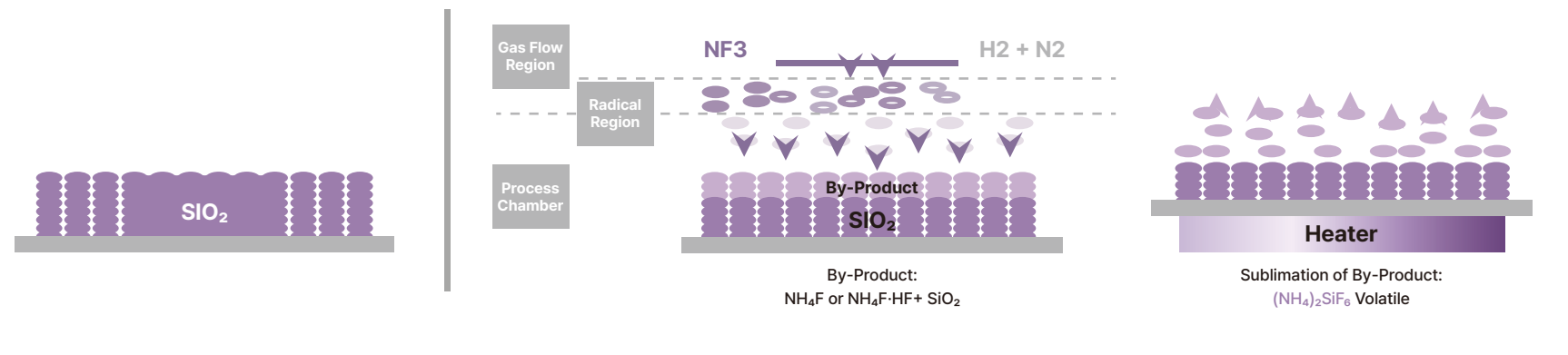
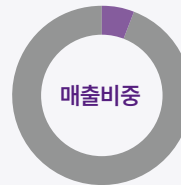
패키징

표면 및 Plasma Oxide Cleaning 선도 장비

INTEGER는 웨이퍼 표면의 자연 산화막과 불순물을 제거하여 무결점 인터페이스를 구현합니다. 소자 미세화에 따라 인터페이스 세정의 중요성이 증가하고 있습니다. INTEGER는 우수한 계면 처리 공정을 제공하여 소자 특성을 확보합니다. Chuck · Baffle 온도 및 화학 최적화를 통해 높은 선택비와 등방성 식각을 달성합니다. 또한 높은 균일성과 생산성을 확보하고 낮은 CoO를 보장합니다.

특징

- Plasma-enhanced cleaning system for removal of oxides, nitrides, and poly-Si
- Excellent cleaning capability for various AR contact patterns
- In-Situ damaged Si removal with high selectivity for SiN
- Excellent controllability for cleaning process





8대 공정

웨이퍼

산화

포토
리소그래피식각
[Asher]

박막 증착

금속 배선

EDS

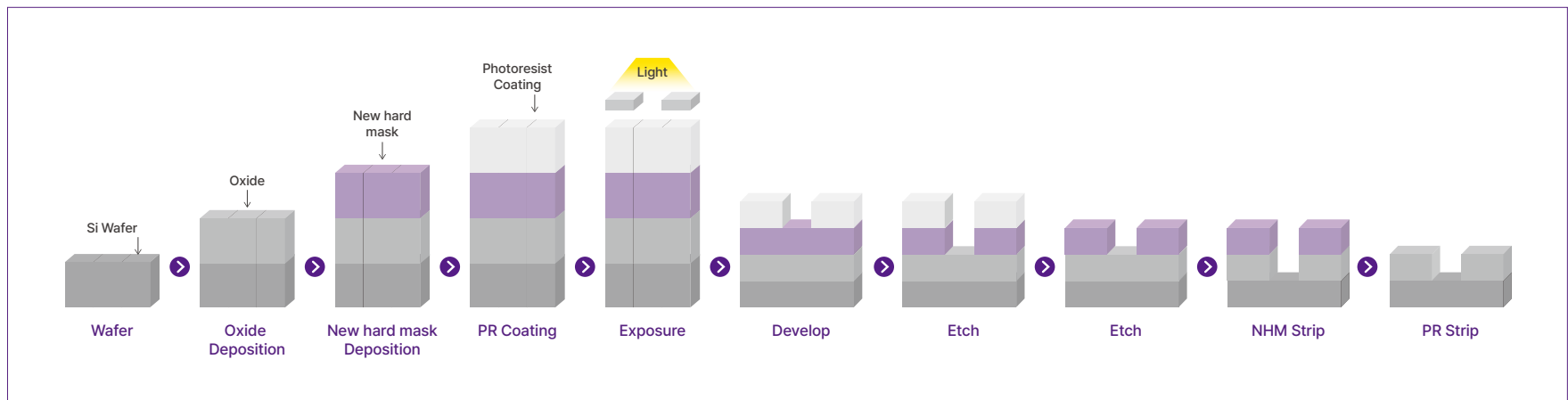
패키징

첨단 노드 하드마스크 제거 플랫폼

소자 미세화로 Aspect Ratio가 증가하면서 높은 내식성 하드마스크가 필요해지고 있습니다. 그러나 기존 제거 방식으로는 이러한 필름을 제거하기 어렵습니다. OMNIS는 높은 선택비로 하드마스크를 제거하면서 기판(Oxide, Nitride 등)의 손상을 최소화합니다.

특징

- Unique product for doped hard mask removal
- Extreme selectivity for dielectric films
- Excellent hard mask strip performance without pattern damage
- Si oxidation controllability





8대 공정

웨이퍼

산화

포토
리소그래피식각
[Etcher]

박막 증착

금속 배선

EDS

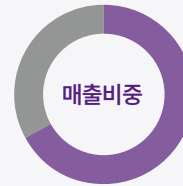
패키징

차세대 공정을 위한 고신뢰성 베벨 에칭 솔루션

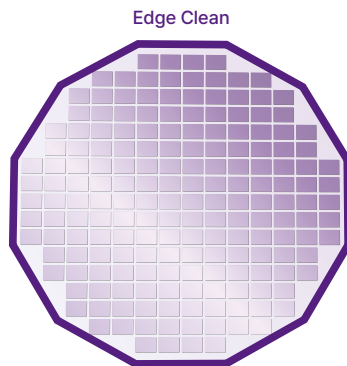
PRECIA는 웨이퍼 에지 필름을 제거하여 수율을 향상시키고, 불필요한 에지 필름을 제거해 파티클 및 표면 손상을 방지합니다. 또한 Auto Wafer Centering 및 비전 얼라인먼트를 통해 균일한 에칭과 안정성을 제공하며, 낮은 CoO를 실현합니다.

특징

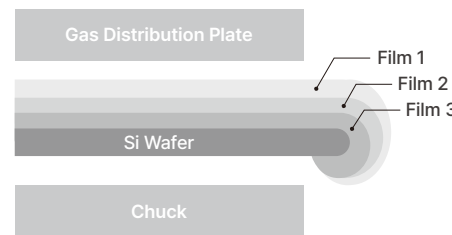
- High productivity & low CoO
- Dual plasma source
- High wafer transfer performance by precise auto wafer centering
- Wafer bevel etch monitoring with vision system



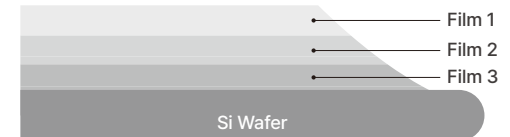
■ 한국 67%
■ 중국 33%



Edge Clean



Bevel Etch 이전



Bevel Etch 이후



8대 공정

웨이퍼

산화

포토
리소그래피

식각

박막 증착

금속 배선

EDS

패키징

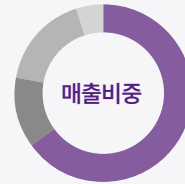
[Advanced
Package]

Descum 및 표면처리 분야 세계 최고의 솔루션 제공

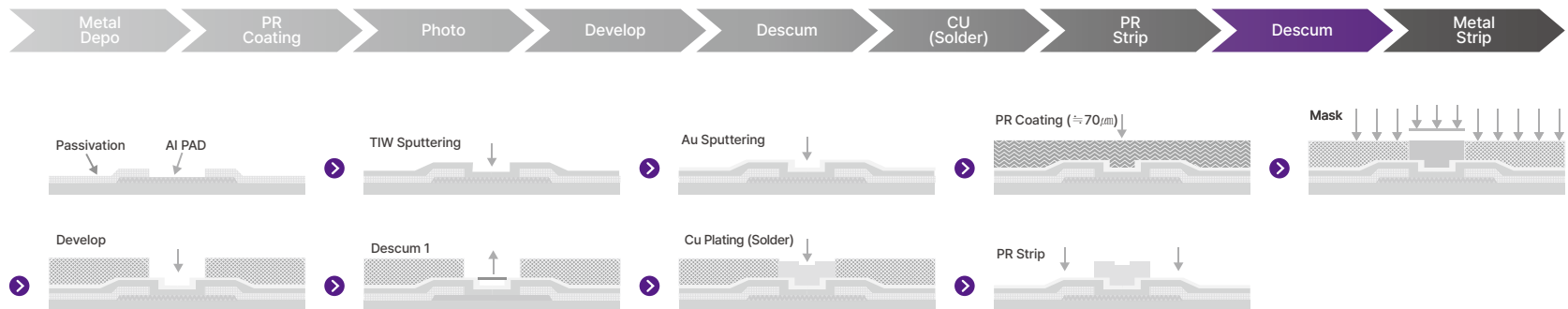
ECOLITE 시리즈는 Wafer-Level 및 Panel-Level 반도체 패키징 생산에서 다양한 Descum 및 표면처리 공정을 지원합니다. Descum은 리소그래피 후 잔류 찌꺼기를 제거하는 공정으로, RDL Profile과 Bump 형성에 중요한 역할을 합니다. 표면처리는 필름 코팅 전·후 잔류물 및 금속 이온을 제거하고, 표면 거칠기와 친수성을 개선하여 접착력을 향상시킵니다.

특징

- High productivity
- High reliability & low CoO
- Single & Dual plasma source
- Small footprint



■ 한국 65%
■ 대만 13%
■ 중국 17%
■ 기타 5%



8대 공정

웨이퍼

산화

포토
리소그래피

식각

박막 증착

금속 배선

EDS

패키징
[Advanced
Package]

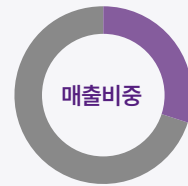
Fluxless Bump Reflow 분야 세계적 경쟁력

Fluxless Bump Reflow 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

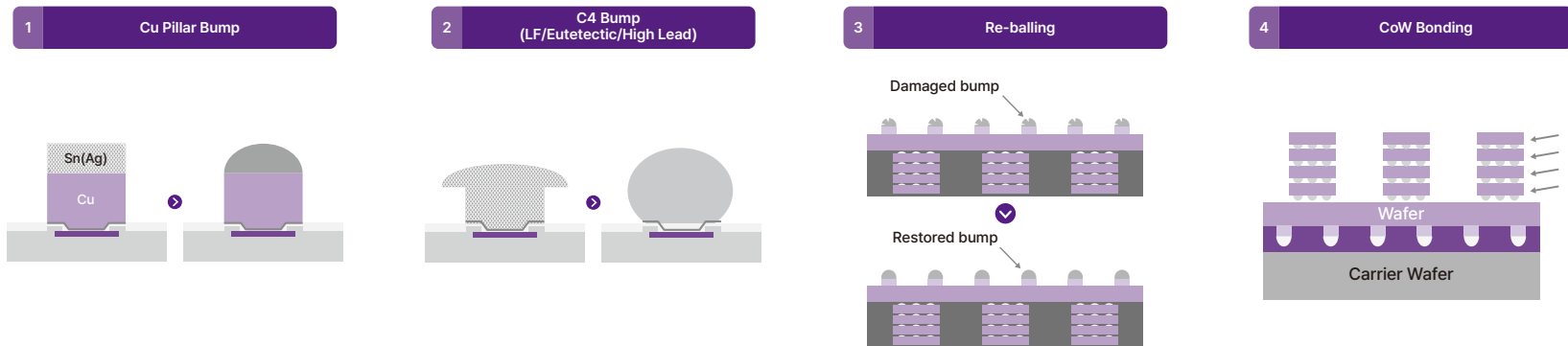
GENEVA는 세계 최초로 Fluxless Reflow 양산에 성공하여 검증된 안정성과 품질을 제공합니다. 또한 Plating Bump Reflow 및 Bonding 응용을 지원하며, 글로벌 고객과 협업합니다. 더불어 HBM, 2.5D와 같은 고사양 패키징 솔루션도 제공합니다.

특징

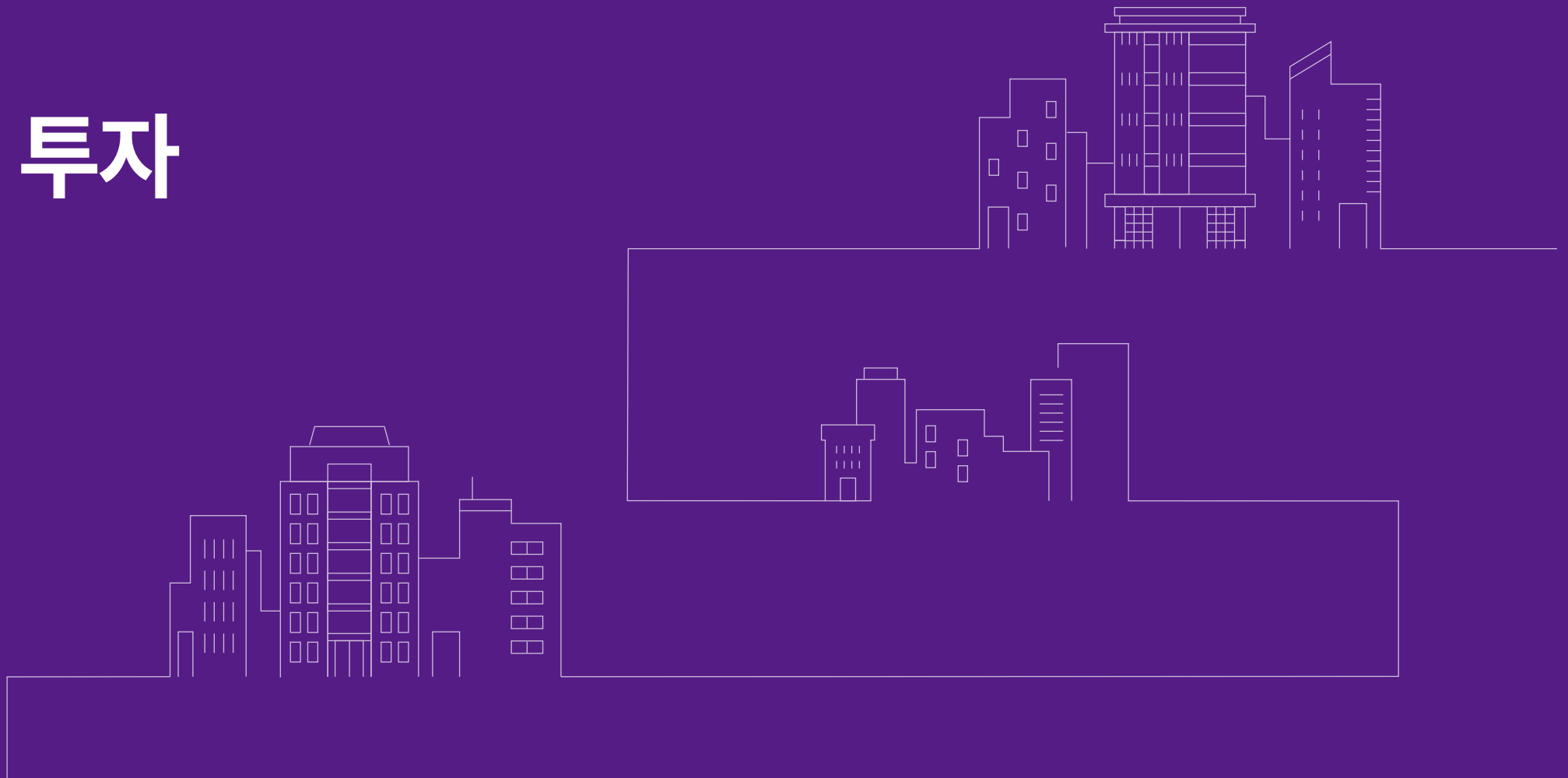
- Low CoO & high reliability
- Small footprint
- Warpage minimization
- High productivity
- High throughput & yield



■ 한국 30%
■ 대만 70%



투자



연구활동	19
신제품	20
CapEx	22



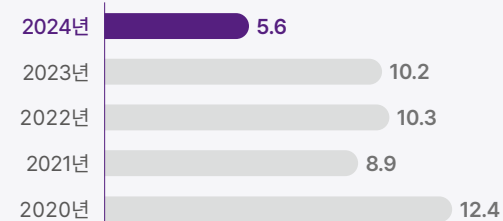
PSK 홀딩스

(단위 : 백만원, %)

연도	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연구비	4,918	7,296	7,514	9,682	12,080
매출액	39,774	81,624	72,791	94,716	215,508
인원	86	94	91	91	112
연구원	33	34	33	34	41
연구인원 비율	38.4	36.2	36.3	37.4	36.6

* 연결 기준

매출액 대비 연구비 (%)



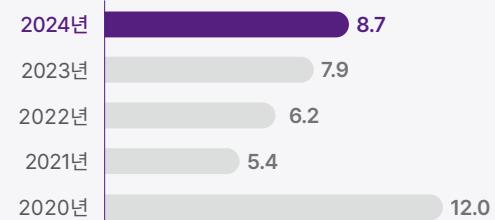
PSK

(단위 : 백만원, %)

연도	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연구비	31,936	24,153	28,755	27,720	34,439
매출액	265,730	445,804	460,909	351,863	398,051
인원	302	330	343	334	330
연구원	109	120	122	122	127
연구인원 비율	36.1	36.4	35.6	36.5	38.5

* 연결 기준

매출액 대비 연구비 (%)



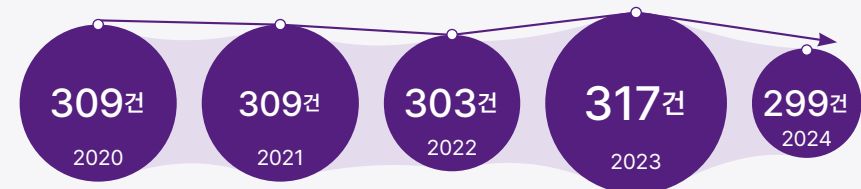


(단위 : 백만원, 건)

	연구비	특허권(누적)	신규 장비
2020년	4,918	309	Descum (II ver.)
2021년	7,296	309	Reflow (STP200xp ver.)
2022년	7,514	303	Reflow (xpd ver.)
2023년	9,682	317	
2024년	12,081	299	Descum (xp L ver.)

* 2019년 2월 이전 특허권은 분할 신설법인과 존속법인이 공동소유

특허권(누적)



Descum (II ver.)



Reflow (xpd ver.)

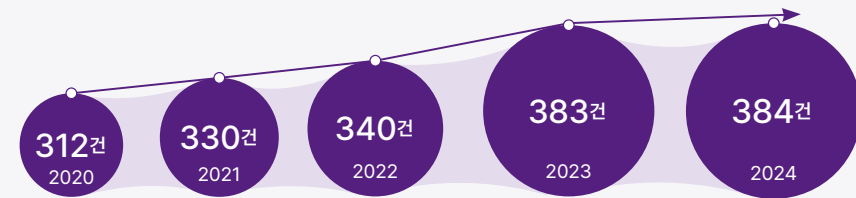


(단위 : 백만원, 건)

	연구비	특허권(누적)	신규 장비
2020년	31,936	312	
2021년	24,153	330	Bevel Etch
2022년	28,755	340	
2023년	27,720	383	
2024년	34,439	384	

* 2019년 2월 이전 특허권은 분할 신설법인과 존속법인이 공동소유

특허권(누적)



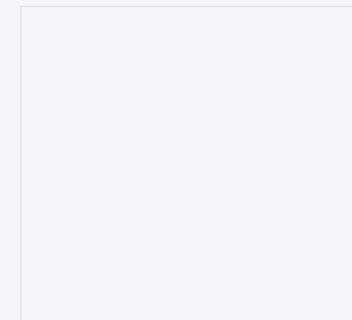
Dry Cleaning



NHM Strip



Bevel Etch



New Dry Cleaning

PSK 판교 캠퍼스



위치	경기도 성남시 수정구 금토동 일원 (판교 제2테크노밸리)
규모	대지면적 4,544 제곱미터 연면적 41,627 제곱미터 (약 12,592평)
투자금액	825억원
준공	2024년 5월

용인 반도체클러스터 일반산업단지



위치	경기도 용인시 처인구 원삼면 독성리, 고당리, 죽능리 일원 (SK 하이닉스 인근 부지)
규모	대지면적 15,412 제곱미터 (약 4,662평) 용적률 350% 이하
투자금액	N/A
준공	2028년 예정

ESG



ESG 경영	24
환경	25
사회	26
지배구조	28
고객사 평가	29



CEO Message

지속가능한 미래를 창조하는 ESG 경영의 모범기업이 되겠습니다.

존경하는 이해관계자 여러분, 안녕하십니까?

지난 30여년간 PSK그룹에 변함없는 관심과 지지를 보내주시는 주주, 고객, 협력사, 그리고 임직원 여러분께 진심으로 감사드립니다.

2019년부터 발생한 COVID-19 팬데믹 지속과 글로벌 공급망 이슈 등 쉽지 않은 경영환경이 지속되고 있으며 기후변화, 환경오염, 인플레이션 등 수많은 환경적, 사회적 문제로 인해 “지속 가능한 미래”를 구축하는 것이 더욱 중요해졌습니다.

이러한 시대 변화에 한 발 앞서 대응하기 위해 PSK그룹은 지속 가능성을 경영의 최고 가치로 삼고 회사의 각 조직에 적용하고자 합니다.

PSK그룹은 지속가능한 경영 체제를 구축하기 위해 ISO 14001 인증을 통한 환경경영시스템을 구축하였으며 자원의 효율적인 사용 및 에너지 절감, 그린(Green) 빌딩 구축 등 친환경 활동을 강화하고 있습니다. 그리고 기업의 사회적 책임을 다하고자 다양한 기부 및 봉사활동을 수행하고 있으며, 노동인권 및 안전 보건 분야에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 이사회 중심 경영 및 전자투표제 도입 등을 통해 지배구조 선진화를 위해 노력하고 있습니다.

PSK그룹은 “종합 프로세스 장비의 글로벌 리더”라는 비전에 ESG의 가치를 더해 회사가 지속가능한 성장을 만들어 내는 데 더욱 집중하겠습니다. 감사합니다.

피에스케이홀딩스 주식회사
대표이사 박경수

박경수



피에스케이 주식회사
대표이사 이경일

이경일



ESG 위원회



자원



- 용지 및 잉크·토너 사용 절감
- 청소용품 구매 절감
- 생산목표 연계 불량자재 발생 감소
- 분리수거 확대, 폐목재 처리방안 검토
- 식수예약시스템을 통한 조리양 조절로 음식폐기물 감소

에너지



- 계절별 냉각탑(외기) 적정 활용으로 설비 전력 사용량 감소
- 태양광 발전, 절전활동, 수도절약활동
- 흡수기 냉동기 미가동으로 냉난방 열사용량 감소

유틸리티



- 생산·연구 장비의 스케줄 제어 on/off 관리 독려
- 질소 사용량 표준화로 Leak 개선, 불필요한 상시 Flow off
- 산소 누설 또는 불필요한 사용처 색출 및 개선
- 특수가스의 적절한 사용처 확인 후 Gas 공급
- 유기물질 사용량 표준화 지속관리로 공급량 조절

2000年12月

최태원씨는 부회장이자 (자비) '일서야 한다'를 천명한 채운을 일하며 대한 일개, 개발, 제조, 유통, 시공을 맡고 있다. 그는 "가장 경쟁력을 갖춘 기업에 대한 지원"을 사내의 직원들을 위한 기업에 투자함으로써 자립을 시키고, 결국 일 지위를 갖추는 것은 최상위 경영진에게만 국한되어 한 번도 일과 관련된 업무에 참여하는 것은 아니라는 의견과도 일치한다. 최태원 부회장은, 국유기업 수 있도록 한 것을 말한다.

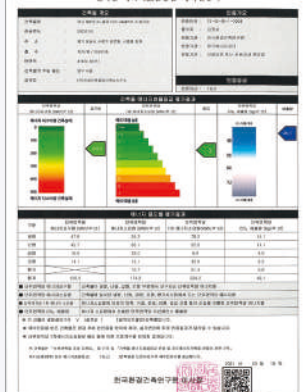
- [illegible]

[illegible]

2021년 12월 4일
국립고려사편찬위원회
국립고려사편찬위원회

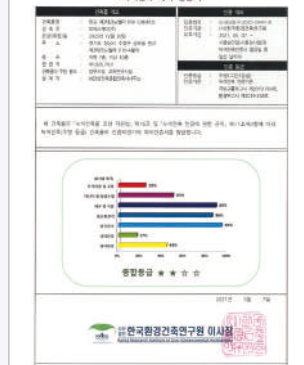
[품질 환경 안전 보건 방침]

전국물 에너지효율등급 서버인증서



[에너지효율등급 예비인증서]

녹색건축 예비 인증서



[에너지효율등급 예비인증서]



ISO 인증, 안전보건 및 중대재해 대응



안전보건

1. 안전보건목표	▶ 매년 안전보건목표 수립 및 연 2회 모니터링, 준수평가 실시
2. 유해위험기계기구	▶ 자체 정기검사 실시
3. 비상사태	▶ 잠재적 비상 사태 및 위험성 식별 및 평가, 대응 프로그램 수립, 비즈니스연속성계획(BCP), 정기훈련, ERT 교육
4. 임직원 안전보건	▶ 정기 교육, 정기 건강검진, 건강관리프로그램 운영

중대재해 대응

1. 예방	▶ 고위험 작업 및 유해위험요인 식별, 작업 장소에 비상경광등 및 비상연락망 설치
2. 중대재해 대응 프로세스 구축	▶ 위험요인별 맞춤 시나리오 구축, 연 2회 대응훈련 실시
3. 비상대책위원회	▶ 중대재해 발생시 긴급 비상대책위원회 및 산업안전보건위원회 소집
4. 재발 방지 대책 수립	▶ 재발 방지 대책 이행계획서, 작업 프로세스 개정
5. 모니터링 및 교육	▶ 지속적인 모니터링 및 안전교육 실시



[ISO 45001 인증서]



협력사 관리

매년 PQCA(PSK Quality Certification Awards)를 통하여 우수 BP(Business Partner)사를 선정하여 시상 및 협력사 관리 활동 시행

2024년 PQCA

일시	2025년 2월 3일 PSK 판교캠퍼스
참가	PSK Group Key Partner
내용	2024년 구매, 품질, 보안, 전략 공유 및 우수 BP사 수상
우수업체 선정 기준	PSK SQP(Supplier Quality Platform)에 근거하여 Key Partner의 품질, 납기, 협조도 3부문 지표를 측정



2024년 사회공헌활동

PSK 그룹 봉사단 '봉우리'는 노인, 아동, 장애인 등 사회의 취약계층에 다양한 사회 공헌 활동을 수행

1월 17일
연탄 나눔



5월 18일
환경정화활동



9월 9일
추석 나눔



10월 23일
이웃사랑 바자회



11월 3일
아름다운 동행 마라톤



11월 23일
김장 나눔





PSK 홀딩스

이사회	박경수 의장·대표이사	양재균 사내이사	박진경 사내이사	강사윤 사외이사	정진욱 사외이사
	- 고려대 경영학 학사 - 미국 캘리포니아주립대(원) MBA - 피에스케이(주) 이사회 의장	- 서울대 금속공학 학사 - KAIST(원) 재료공학 석사 - 대우반도체 근무	- KAIST 산업디자인 학사 - NHN 근무 - XLGAMES 근무	- 삼성전자(주) PKG개발팀 팀장 - 삼성전기(주) PLP사업팀 팀장 - 한국마이크로 전자 및 패키징 학회장	- KAIST 물리학과 박사 - 한양대학교 전기공학과 교수 - 반도체디스플레이 기술학회 플라즈마 RF 연구회장

PSK

이사회	박경수 의장	이경일 대표이사	김동진 사내이사	강필성 사외이사	정우인 사외이사
	- 고려대 경영학 학사 - 미국 캘리포니아주립대(원) MBA - 피에스케이홀딩스(주) 이사회 의장	- KAIST(원) 재료공학석사 - 서울대(원) 재료공학박사 - Applied Materials 근무	- Columbia Business School MBA - 삼성전자(주) 근무 - 휴렛패커드 근무	- 서울대(원) 산업공학과 박사 - 서울대학교 산업공학과 부교수 - LG CNS 제조 AI 자문교수	- KAIST(원) 재료공학과 박사 - 연세대학교 연구교수 - Lam Research Korea 근무
경영진	하형찬	최기보	박연경		
	- Lehigh Univ Materials Science(원) 박사 - SK Hynix 근무 - Applied Materials 근무	- 연세대(원) 물리학 석사 - 삼성전자(주) 근무 - Applied Materials 근무	- 서울대(원) 경영학 석사 - 삼성전자(주) 근무 - 롯데홈쇼핑 근무		

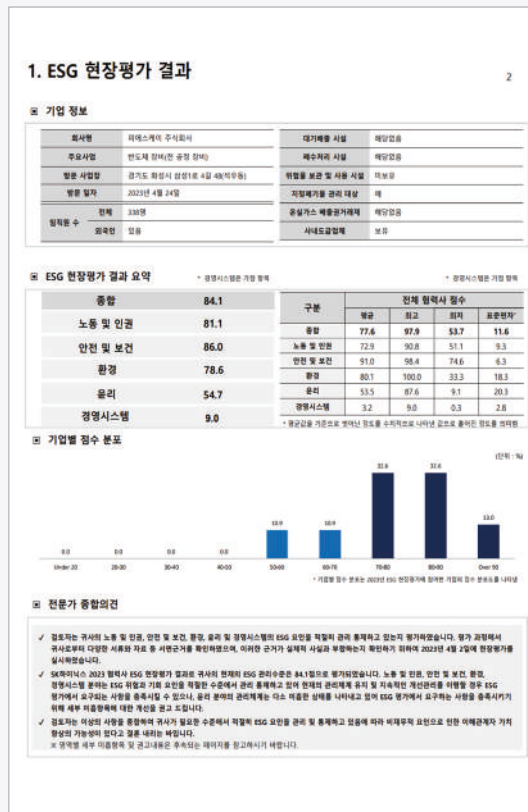


삼성전자



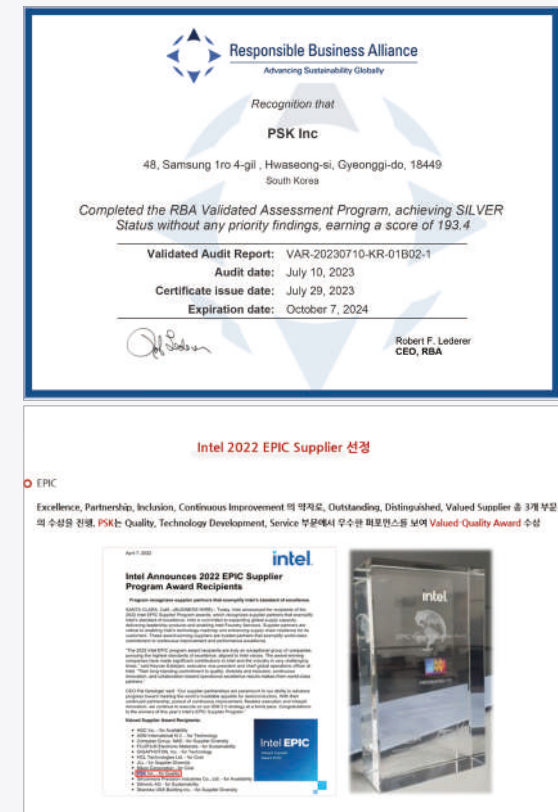
2021년 온라인 자가평가 결과, ESG 각 영역에서 전체 협력사의 평균을 상회하는 수준을 달성 종합점수 95.8점으로 매우 우수한 평가를 받음

SK 하이닉스



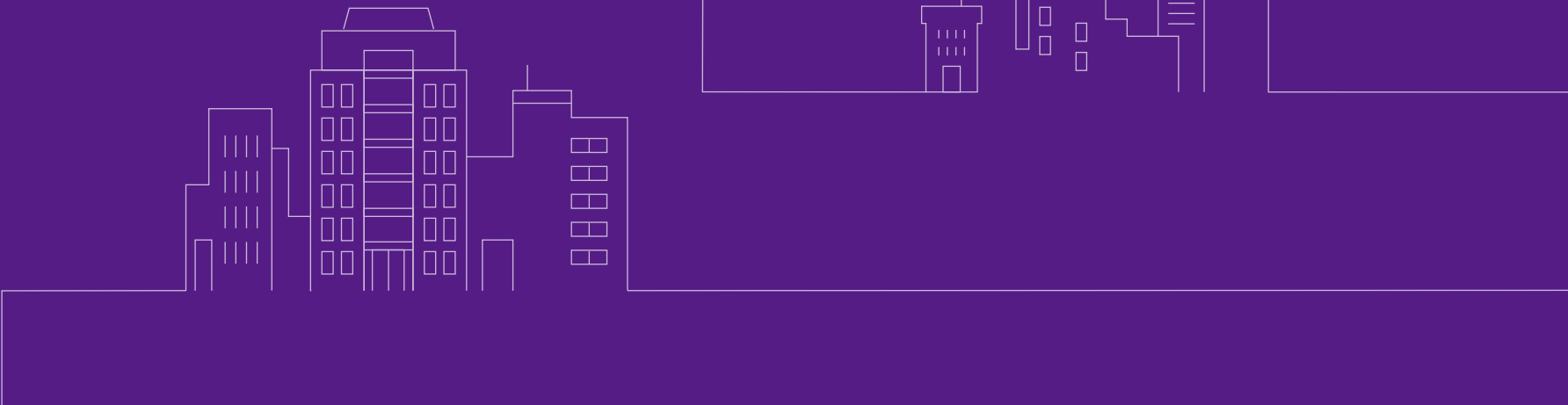
2021년 온라인 자가평가를 진행한 후, 2023년 4월 고객사가 본사를 방문하여 현장실사를 실시한 종합점수 84.1점으로 전체 협력사의 평균을 상회하는 수준을 달성, 상위 약 45% 범위 내 위치함

인텔



2022년 11월 평가를 시작하여 약 1년간 개선요구사항들을 보완하여 총점 200점 중 193.4점 달성함

성과



재무정보	31
주가정보	33



2025년 3분기 실적

(단위: 십억 원)

	25년 3분기	25년 2분기	전분기 대비 증감	24년 3분기	전년 대비 증감
매출액	90.6	34.7	61.7%	39.1	131.7%
매출총이익	57.3	20.8	63.7%	22.5	154.7%
판매관리비	16.1	12.3	23.6%	8.2	96.3%
영업이익	41.2	8.5	79.4%	14.3	188.1%

*작성기준: 연결재무제표

요약재무제표

재무상태표

(단위: 십억 원)

	2022년		2023년		2024년	
자산	328.4	100.0%	401.4	100.0%	513.6	100.0%
유동자산	128.4	39.1%	165.2	41.2%	241.1	46.9%
부채	46.3	14.1%	60.1	15.0%	82.1	16.0%
유동부채	22.2	47.9%	35.1	58.4%	51.7	63.0%
자본	282.2	85.9%	341.3	85.0%	431.5	84.0%
자본금	10.8	3.8%	10.8	3.2%	10.8	2.5%
부채자본비율	16.4%		17.6%		19.0%	

*작성기준: 연결재무제표

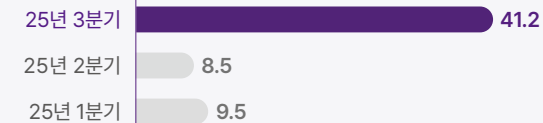
손익계산서

(단위: 십억 원)

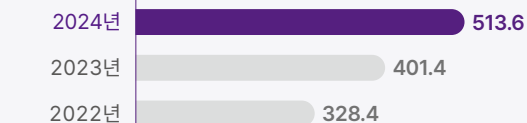
	2022년	2023년	2024년
매출액	72.8	94.7	215.5
매출총이익	42.5	57.9	135.8
영업이익	16.9	27.0	88.5
당기순이익	40.8	42.7	95.8
영업이익률	23.2	28.5	41.1

*작성기준: 연결재무제표

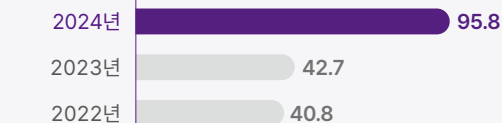
영업이익



자산



당기순이익





2025년 3분기 실적

(단위: 십억 원)

	25년 3분기	25년 2분기	전분기 대비 증감	24년 3분기	전년 대비 증감
매출액	104.1	108.5	-4.2%	118.0	-11.8%
매출총이익	52.0	51.2	1.5%	60.8	-14.5%
판매관리비	28.6	30.7	-7.3%	31.6	-9.5%
영업이익	23.4	20.6	12.0%	29.1	-19.6%

*작성기준: 연결재무제표

요약재무제표

재무상태표

(단위: 십억 원)

	2022년		2023년		2024년	
자산	472.2	100.0%	494.4	100.0%	569.4	100.0%
유동자산	384.0	81.3%	353.6	71.5%	398.6	70.0%
부채	119.3	25.3%	101.8	20.6%	97.6	17.1%
유동부채	100.9	84.6%	86.1	84.6%	81.2	83.2%
자본	353.3	74.8%	392.5	79.4%	471.7	82.8%
자본금	14.6	4.1%	14.6	3.7%	14.6	3.1%
부채자본비율	33.8%		25.9%		20.7%	

*작성기준: 연결재무제표

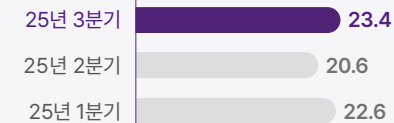
손익계산서

(단위: 십억 원)

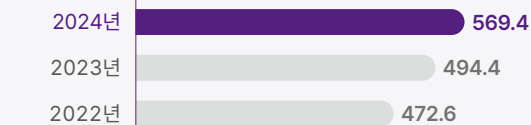
	2022년	2023년	2024년
매출액	460.9	351.9	398.1
매출총이익	213.4	164.6	209.6
영업이익	91.8	54.1	84.0
당기순이익	77.4	52.5	79.1
영업이익률	19.9	15.4	21.1

*작성기준: 연결재무제표

영업이익



자산



당기순이익





PSK 홀딩스

(통화: 원, 1주)

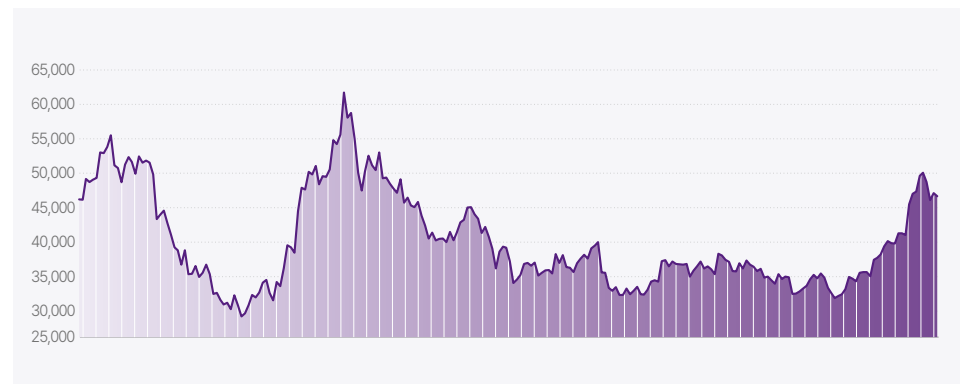
	2022	2023	2024
배당금	500	600	700

*작성기준: 연결재무제표

	2022	2023	2024
배당성향	25.0%	30.3%	15.8%

*작성기준: 연결재무제표

	2022	2023	2024
EPS (₩)	1,890	1,980	4,444
BPS (₩)	13,597	15,829	20,010
PER (x)	3.6	13.6	8.6
PBR (x)	0.5	1.7	1.9
ROE (%)	15.3	13.7	24.8
ROA (%)	12.9	11.7	20.9
ROIC	17.2	28.9	61.0



PSK

(통화: 원, 1주)

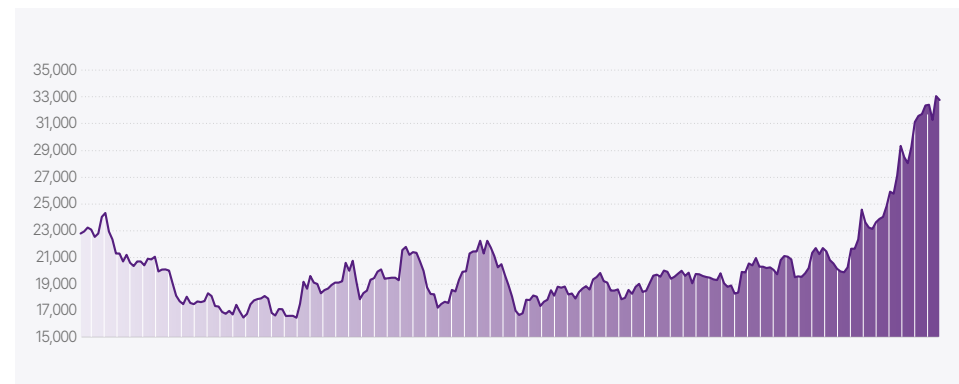
	2022	2023	2024
배당금	400	200	400

*작성기준: 연결재무제표

	2022	2023	2024
배당성향	15.0%	11.0%	14.6%

*작성기준: 연결재무제표

	2022	2023	2024
EPS (₩)	2,647	1,813	2,732
BPS (₩)	12,197	13,552	16,285
PER (x)	5.8	11.6	6.0
PBR (x)	1.3	1.6	1.0
ROE (%)	24.1	14.1	18.3
ROA (%)	17.5	10.9	14.9
ROIC	35.8	20.0	28.5



Platform Solution Knowledge



PSK GROUP

경기도 성남시 수정구 금토로 75 (13453)

031)660-8799 | www.pskholding.com | www.pskinc.com